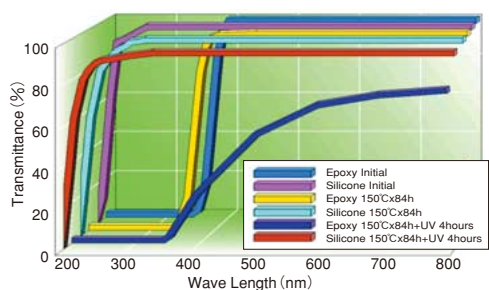


| 分類 | 2液エラストマー | | | | | | 1液ゲル | 2液ゲル | | |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------|----------|--|
| | 付加反応 | | | | | | | | | |
| 製品名 | JCR6125 | JCR6126 | JCR6140 | OE-6336 | EG-6301 | JCR6175 | JCR6109 | JCR6110 | OE6250 | |
| 硬化条件(代表例) | 150°C/1hr | | | | | | 70°C/1hr(予備加熱) +150/16hr(硬化) | 150°C/1hr | 80°C/1hr | |
| 混合比 | 100:10 | | 100:100 | | | | NA | 100:10 | 100:100 | |
| 特長 | 高チクソ性 | | 透明 | 高透明 | 高透明 | 高透明 | 高屈折率 | 耐寒性 | 高透明 | |
| | | | | | | | | α線対策 | | |
| 用途例 | LED, LCDディスプレイ | LED | CCD | LED | | | フォトグレー | ロジックチップコート | LED | |
| | イメージセンサー、TPH | | | | | | | 圧力センサ | | |
| 硬化前 | | | | | | | | | | |
| 外観 | 半透明/透明 | 半透明/透明 | 透明/半透明 | 透明/透明 | 半透明/透明 | 透明/微濁 | 半透明 | 透明/透明 | 透明/透明 | |
| 粘度 (Pa·s) | 9 | 85 | 3.2 | 1.46 | 3.4 | 5.2 | 3.9 | 2.1 | 0.45 | |
| 硬化後 | | | | | | | | | | |
| 密度 (g/cm ³) | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | — | 1.04 | 1.00 | — | |
| 硬さ [JIS タイプA] | 23 | 27 | 40 | 65 | 70 | 30 | NA | NA | NA | |
| 針入度 [JIS K 2235] (mm/10) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 167 | 225 | 49*1) | |
| 伸び (%) | 230 | 290 | 175 | 70 | 75 | 45 | — | — | — | |
| 引張強さ (MPa) | 0.8 | 1.8 | 5.3 | 7 | 9 | 0.3 | — | — | — | |
| 線膨張係数 (1/K) | 3.1E-04 | 3.0E-04 | 3.2E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | — | — | — | — | |
| 熱伝導率 (W/m·K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | |
| 引張りせん断接着強さ (MPa) | 0.4 | 1.0 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | |
| Na (ppm) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |
| K (ppm) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |
| U (ppb) | — | — | — | — | — | — | — | 1以下 | — | |
| Th (ppb) | — | — | — | — | — | — | — | 1以下 | — | |
| 体積抵抗率 (Ω·cm) | 3E+14 | 4E+15 | 2E+14 | 3E+15 | 7E+15 | 1E+14 | 2E+15 | 4E+14 | 2E+15 | |
| 絶縁破壊強さ (kV/mm) | 24 | 24 | 31 | 25 | 28 | 28 | 18 | 15 | 23 | |
| 誘電率 [1MHz] | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | — | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 誘電正接 [1MHz] | 8E-04 | 6E-04 | 9E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | — | 5E-04 | 6E-04 | 1E-03 | |
| ヤング率 (MPa) | 0.66 | 0.69 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | |
| ポアソン比 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tg (°C) | — | — | -119 | — | -124 | -28 | — | -112 | — | |
| 屈折率 | — | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.54 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | |
| 透過率 (%) [1mm厚、450nm] | — | — | — | 98 | 97 | 97 | — | 99 | 100 | |

*1) JIS K2220、1/4コーン
 ※半導体エンキャップ材の硬化機構については、本カタログ2ページの「加熱硬化について」をご参照ください。また、硬化阻害（本カタログ2ページをご参照ください）にお気をつけください。1液製品については冷蔵保管が必要です。 ※LED封止用材料については本カタログの20ページ、オプティカルソリューションをご覧下さい。



note Thickness of samples=0.2mm
 epoxy:typical optical grade epoxy
 silicone:EG6301

